



MSP-20-TK

マグネトロンスパッター

FE-SEM 向けタングステンコーター

- 電子顕微鏡向けタングステン薄膜のコーティング装置です。
- 超高分解能SEMにおいて超高倍率の観察に活躍します。(20万倍以上)
- 試料傾斜・回転機構(オプション)を使用することにより回り込み性能の向上も可能。
- 貴金属/Mo/Cr/Ni/Ta/Cu/Tiなどの金属板(オプション)をコーティングすることが可能です。
- 電圧・電流容量の変更(オプション)により、殆どの金属コーティングを可能にします。
- 空冷式マグネトロンターゲット採用で、試料ダメージを最小限にし、ターゲットの温度上昇を防ぎます。
- 雰囲気ガスはアルゴンガスを使用。
- 条件出しの際の操作をより簡単にしたボタンレイアウト。
- 条件出し完了後はボタン1つでフルオート動作。(貴金属のみ)
- インターロック・安全機構が充実した高性能コーティング装置。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

特徴・仕様

特徴

- ★ この装置は電子顕微鏡などの試料にタングステンコートを施す装置です。
 - ★ ターゲットは空冷式マグネトロン方式で、貴金属以外の金属コーティングを可能にし、イオンダメージ・熱ダメージを最小限に抑えています。
 - ★ マニュアル・調整操作は右から左へ順にスイッチを押していただくだけの使い易いレイアウト。押し間違えても作動しない誤動作防止機能付き。複数人の使用でも安心してお使いいただけます。
 - ★ 貴金属ターゲット使用時は、調整後に中央のオートコントロール スイッチを押すだけ。
 - ★ 試料台はイオンダメージを軽減するためフローティング(絶縁)方式を採用。
 - ★ ターゲット金属板はタングステン 1mm 厚を標準で付属。
- 注) アルゴンガスの接続が必要となります。(お客様準備品)

オプション

- ★ ターゲット金属板: Au/Au-Pd/Pt/Pt-Pd/Pd/Ag/Mo/Cr/Ni/Cu/Ta/Ti/など。(標準ターゲットでスパッタ可能な金属のみ)
- ★ 試料傾斜・回転機構。 * 但し、試料高さ調整機能が使用出来なくなります。
- ★ 磁場キャンセル Ni プレート : 貴金属ターゲット Au/Au-Pd/Pt/Pt-Pd/Pd/Ag 用。

仕様

No	項目	仕様
1	ターゲット	φ50mm 空冷式マグネトロン
2	ターゲット金属(厚さ 0.5mm)	標準: W、オプション: Mo/Cr/Ni/Ta/Cu/Ti/貴金属
3	印加電圧/電流	電圧DC 0~500V/電流 DC0~200mA
4	試料ステージ	φ47mm フローティング方式
5	ターゲット-試料 間隔	50~70mm
6	試料サイズ	直径 ≤ φ45mm、高さ: ≤ 30mm
7	チャンバーサイズ	内径 149mm、深さ 126mm
8	タイマー	OMRON 社製電子タイマー
9	排気系	外置き RP50ℓ/min 13.9kg
10	到達真空度	1(Pa) 以下
11	雰囲気ガス導入	1/4' 導入パイプ、0.07MPa 以下使用。
12	安全対策	系統別フューズ、上蓋開放感知センサー
13	装置サイズ	本体 W354mm × D368mm × H430 22kg
14	電源	AC100V, 15A アース線付3芯プラグ使用3m